



2013年6月11日
株式会社日立製作所
執行役社長 中西 宏明
(コード番号:6501)
(上場取引所:東・大・名)

会社分割によるパワー半導体事業の再編について

事業強化を目的に設計、製造および販売を一体化し、多様化するニーズへ迅速に対応

株式会社日立製作所(執行役社長:中西 宏明/以下、日立)は、パワー半導体事業の多様化するニーズへ迅速に対応することを目的として、2013年10月1日付で、日立のパワー半導体事業を子会社である日立原町電子工業株式会社(取締役社長:小田井 恒吾/以下、日立原町電子)に移管し、設計、製造から販売までの一貫体制を構築することを決定しました。具体的には、会社分割(以下、本会社分割)により、日立のパワー半導体事業の設計、製造、品質保証、営業部門等を日立原町電子に承継させるとともに、日立原町電子の会社名を「株式会社日立パワーデバイス」(仮称)に変更します。なお、本会社分割は、100%子会社に日立の事業部門を承継させる会社分割であるため、開示事項・内容の一部を省略しております。

1. 組織再編の目的

パワー半導体の市場環境は、中国経済の減速や欧州の経済危機などにより大きく変化しているものの、低炭素社会の実現に向けた各領域での取組みは今後もグローバルレベルで継続的に進むことが予想されています。このため、省エネルギーに貢献するパワー半導体市場はさらに大きく拡大していくものとみられています。

今回の会社分割は、鉄道車両、建設機械、発送電設備、自動車、家電など、社会イノベーション事業でのキー・デバイスであるパワー半導体製品の日立グループ内での設計、製造から販売までの業務を一体化し、情報や意思決定の流れをさらにスピードアップすることで、日立のコンポーネント製品の競争力を強化することを目的としています。

今後、新会社では鉄道、建設機械、風力発電、電力流通などに使用される世界最高レベルの低損失を実現した高耐圧 IGBT の量産を推進するとともに、次世代素子として期待の高い SiC デバイスの実用化に向けた開発を加速します。また、インバータ IC については国内市場の豊富な実績をもとに新興国での省エネエアコンの需要拡大に対応していきます。加えて、自動車分野では、さらなる長寿命化、高信頼化を実現した第三世代(樹脂型)オルタネータ用ダイオード等によって事業を積極的に推進していきます。

また、販売面ではグローバルに拡大するパワー半導体市場に対して、海外営業拠点を順次拡充するとともにフロントセールス及びフロントセールスエンジニアを増強し、成長、進化する市場ニーズを捉え、お客様の要望に応じていきます。

2.会社分割の要旨

(1)会社分割の日程

契約締結日	2013年8月(予定)
実施予定日(効力発生日)	2013年10月1日(予定)

(注) 本会社分割は、日立においては会社法第784条第3項に定める簡易吸収分割であり、日立原町電子においては会社法第796条第1項に定める略式吸収分割であるため、それぞれの株主総会による吸収分割契約の承認を得ずに行います。

(2)会社分割の方式

日立を吸収分割会社とし、日立原町電子を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(3)その他

日立は本会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

その他の会社分割の詳細については、決定しだいお知らせします。

3.会社分割の当事会社の概要

	分割会社	承継会社
(1)名称	株式会社日立製作所	日立原町電子工業株式会社
(2)所在地	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	茨城県日立市弁天町3丁目10番2号
(3)代表者の役職・氏名	執行役社長 中西 宏明	取締役社長 小田井 恒吾
(4)事業内容	情報・通信システム、電力システム、社会・産業システム、電子装置・システム、建設機械、高機能材料、オートモティブシステム、デジタルメディア・民生機器、金融サービス、その他の10セグメントにわたる、製品の開発、生産、販売、サービス	半導体部品、半導体応用機器の製造、販売
(5)資本金	458,790百万円 (2013年3月末日現在)	150百万円 (2013年3月末日現在)
(6)設立年月日	1920年2月1日	1973年2月1日
(7)発行済株式総数	4,833,463,387株 (2013年3月末日現在)	300,000株 (2013年3月末日現在)
(8)決算期	3月31日	3月31日

(9)大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 6.52% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.77% SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS 2.58% 日立グループ社員持株会 2.57% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224 2.18% (2013年3月末日現在)	株式会社日立製作所 100%
--------------	---	----------------

(10)直近事業年度の経営成績及び財政状態(単位:百万円。特記しているものを除く)		
純資産	3,179,287(連結)	926(個別)
総資産	9,809,230(連結)	6,450(個別)
1株当たり 純資産(円)*1	431.13(連結)	3,087.48(個別)
売上高	9,041,071(連結)	12,125(個別)
営業利益	422,028(連結)	△217(個別)
経常利益*2	344,537(連結)	△149(個別)
当期純利益*3	175,326(連結)	289(個別)
1株当たり 当期純利益(円)*3	37.28(連結)	965.70(個別)

*1 日立は米国会計基準を採用しているため、1株当たり株主資本の額を記載しております。

*2 日立は米国会計基準を採用しているため、税引前当期純利益の額を記載しております。

*3 日立は米国会計基準を採用しているため、当社株主に帰属する当期純利益および1株当たり当社株主に帰属する当期純利益の額をそれぞれ記載しております。

4.分割する事業部門の概要

(1)分割する部門の事業内容

パワー半導体に関する設計、製造、品質保証、営業等

(2)その他

その他の分割する事業部門の詳細については、決定しだいお知らせします。

5.会社分割後の承継会社の概要

(1)名称	株式会社日立パワーデバイス(仮称)
(2)所在地	茨城県日立市 (東京本社:東京都千代田区)
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長 山村 雅宏
(4)事業内容	半導体部品・半導体応用製品の設計、製造および販売
(5)資本金	450 百万円
(6)従業員数	約 1,160 名
(7)大株主および持株比率	日立製作所 100%

6.会社分割後の日立の状況

名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期については、いずれも本会社分割による変更はありません。

7.今後の見通し

日立の連結業績に与える影響はありません。

(参考) 当期連結業績予想(2013年5月10日公表)及び前期連結実績(単位:百万円)

	売上高	営業利益	税引前 当期純利益	当社株主に帰属 する当期純利益
当期連結業績予想 (2014年3月期)	9,200,000	500,000	425,000	210,000
前期連結実績 (2013年3月期)	9,041,071	422,028	344,537	175,326

<将来の見通しに関するリスク情報>

本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがあります。

その要因のうち、主なものは以下の通りです。

- ・ 主要市場(特に日本、アジア、米国およびヨーロッパ)における経済状況および需要の急激な変動
- ・ 為替相場変動(特に円/ドル、円/ユーロ相場)
- ・ 資金調達環境
- ・ 株式相場変動
- ・ 持分法適用関連会社への投資に係る損失
- ・ 価格競争の激化(特にデジタルメディア・民生機器部門)

- ・ 新技術を用いた製品の開発、タイムリーな市場投入、低コスト生産を実現する当社および子会社の能力
- ・ 急速な技術革新
- ・ 長期契約におけるコストの変動および契約の解除
- ・ 原材料・部品の不足および価格の変動
- ・ 製品需給の変動
- ・ 製品需給、為替相場および原材料価格の変動並びに原材料・部品の不足に対応する当社および子会社の能力
- ・ 社会イノベーション事業強化に係る戦略
- ・ 事業構造改善施策の実施
- ・ コスト構造改革施策の実施
- ・ 主要市場・事業拠点(特に日本、アジア、米国およびヨーロッパ)における社会状況および貿易規制等各種規制
- ・ 製品開発等における他社との提携関係
- ・ 自社特許の保護および他社特許の利用の確保
- ・ 当社、子会社または持分法適用関連会社に対する訴訟その他の法的手続
- ・ 製品やサービスに関する欠陥・瑕疵等
- ・ 地震、津波およびその他の自然災害等
- ・ 情報システムへの依存および機密情報の管理
- ・ 退職給付債務に係る見積り
- ・ 人材の確保

以 上

このニュースリリースにおける将来予測に関する情報は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいています。このため、実際の結果と大きく異なったり、予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
